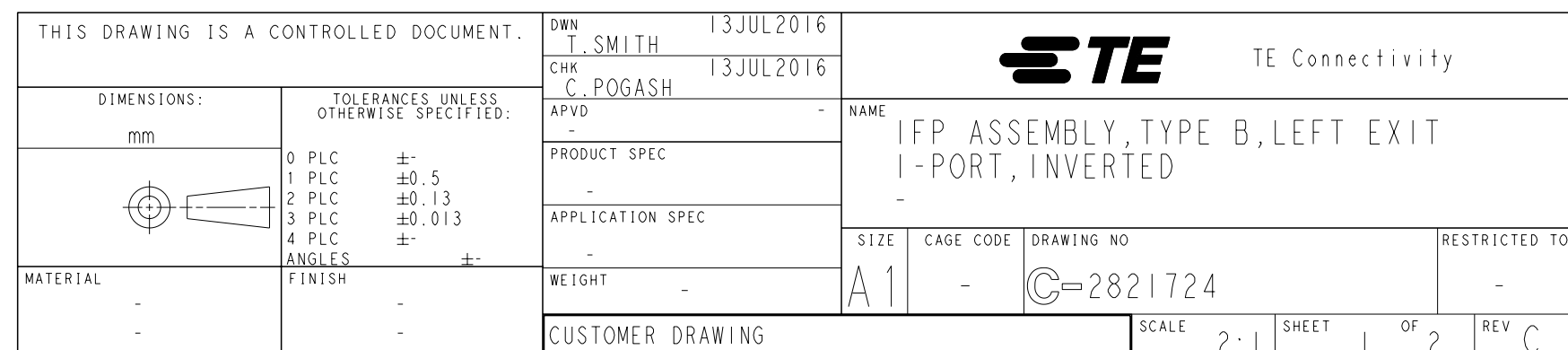




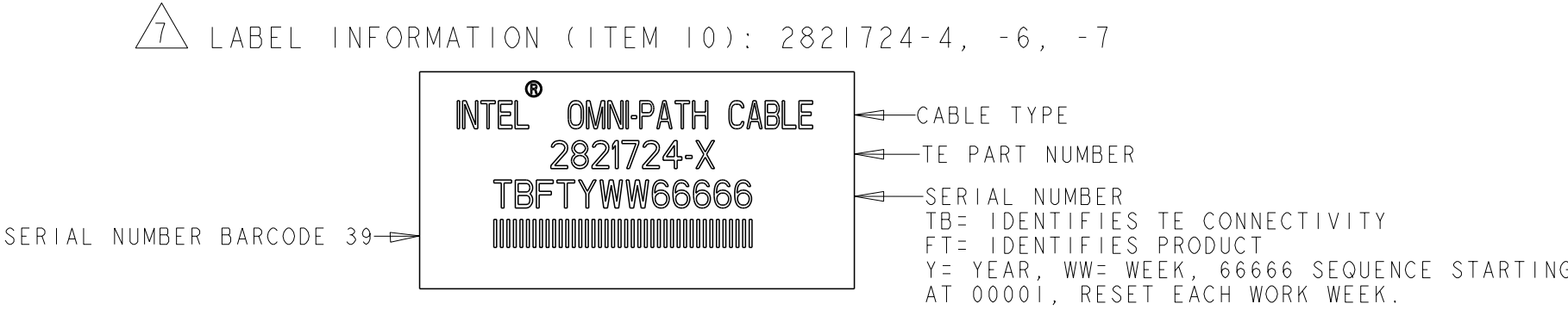
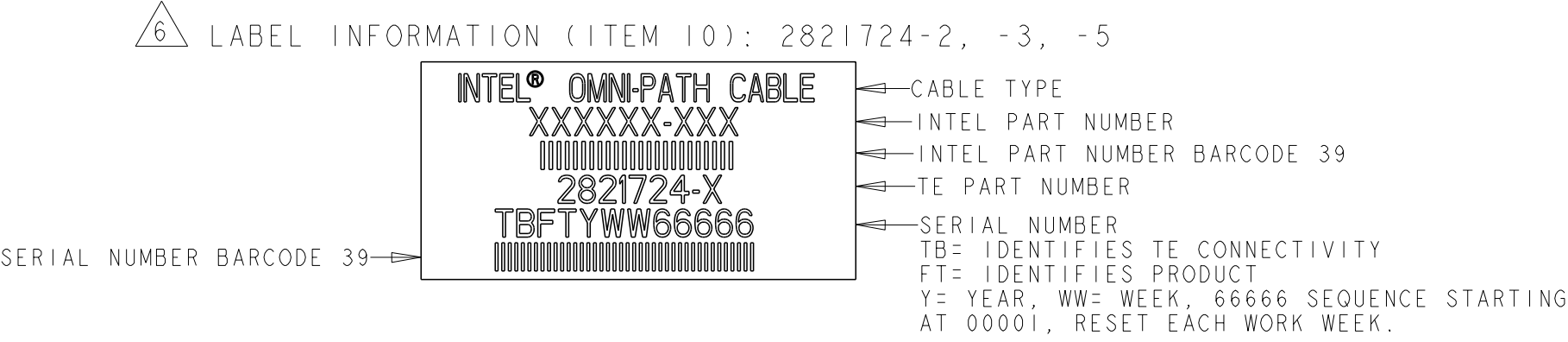
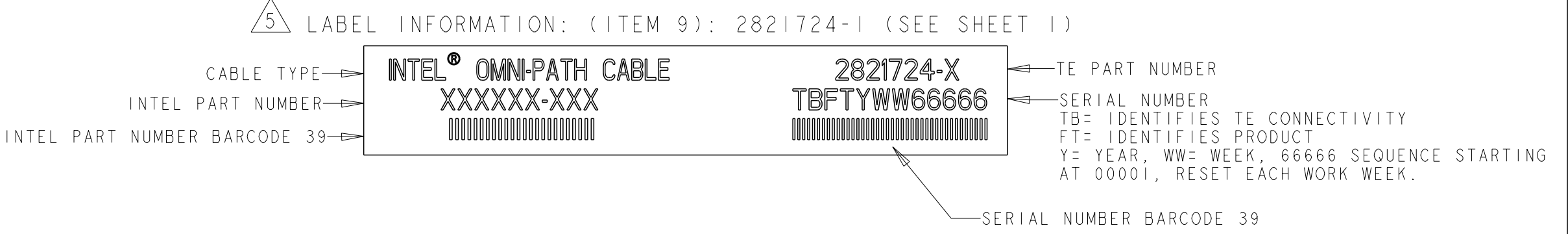
	WRAP (SHEET 2)	40	235±5	H79267-005	1-2821724-1 
	WRAP (SHEET 2)	60	405±5	-	2821724-7
	WRAP (SHEET 2)	60	500±5	-	2821724-6 
	WRAP (SHEET 2)	60	439±5	H74964-005	2821724-5
	WRAP (SHEET 2)	60	419±5	-	2821724-4
	WRAP (SHEET 2)	100	318±5	H86176-005	2821724-3 
	WRAP (SHEET 2)	40	235±5	H79267-005	2821724-2
	FLAG (SHEET 1)	60	178±5	H74963-005	2821724-1
LABEL TYPE		(M)	L	INTEL PART NO	TE PART NO

I	I	I	I	I	I	I	I	PULL TAB	I I
I	I	I	I	I	I	I	-	LABEL, WRAP	10
-	-	-	-	-	-	-	I	LABEL, FLAG	9
AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	SLEEVING, EXPANDABLE	8
AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	85 OHM TWINAX CABLE, 30AWG 25G TURBO TWIN™ 	7
I	I	I	I	I	I	I	I	OVERMOLDED STRAIN RELIEF, LECB	6
I	I	I	I	I	I	I	I	OVERMOLDED STRAIN RELIEF, IFP	5
I	I	I	I	I	I	I	I	DUST COVER, LECB (NOT SHOWN)	4
I	I	I	I	I	I	I	I	DUST COVER, IFP (NOT SHOWN)	3
I	I	I	I	I	I	I	I	LEC 54B RECPT, 54 POSN	2
I	I	I	I	I	I	I	I	IFP PLUG, 28 POSN	1
I - I	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	DESCRIPTION	ITEM NO



REVISIONS					
#	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		SEE SHEET 1			

1. THIS ASSEMBLY CONFORMS TO INTEL PART NO. (SEE TABLE).
2. EACH ASSEMBLY TESTED FOR OPENS, SHORTS AND SIGNAL INTEGRITY.
3. ROHS AND REACH COMPLIANCE: PRODUCT AND PROCESSING MEETS THE REQUIREMENTS OF TE SPECIFICATION TEC-138-702.
4. EACH ASSEMBLY PACKAGED IN AN ANTISTATIC BAG.



8. CABLE ASSEMBLY BUILT IN ACCORDANCE WITH INTEL DESIGN GUIDE 1.0

9 FINISH (CONTACT PADS): 30µIN MINIMUM GOLD PER TE SPEC 112-162-1 OVER 100µIN MINIMUM NICKEL PER TE SPEC 112-25-2.

10 FINISH: 50µIN MINIMUM GOLD PER TE SPEC 112-162-5, IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, OVER 50µIN MINIMUM NICKEL PER TE SPEC 112-25-2 ON ENTIRE STOCK.

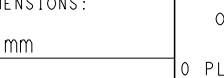
11 CABLE PART #: 023B2LF023
CABLE SPEC: 104-1587

12 CABLE ASSEMBLY LENGTH OFFERED BY TE IS NOT REFERENCED WITHIN INTEL DESIGN GUIDE 1.0

13 REQUIRED SPECIAL PACKAGE FOLLOWING CUSTOMER SPEC: J51641_Omnipath_kit_TE.docx AND BELOW TABLE.

PC - L6 SYSTEMS - GOLD	DESCRIPTION	UPC/EAN	MM	TA	TA REV	PBA#/ITEM/SPARE	TE CROSS PN
AXXCBL2351FPLI	IFT Omnipath Left 235 mm	UPC: 735858346092	958252	J53188-001	I	H79267-005	I-2821724-1
		EAN: 5032037106375					

2821724-2, -3, -4, -5, -6, -7, 1-1
WRAP AROUND LABEL
REQUIREMENT
ALL ASSEMBLY REQUIREMENTS
SAME AS -1 EXCEPT FOR
LABEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. SMITH 13JUL2016		 TE Connectivity	
		CHK C. POGASH 13JUL2016			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		-		IFP ASSEMBLY, TYPE B, LEFT EXIT I-PORT, INVERTED	
		PRODUCT SPEC		-	
		APPLICATION SPEC		-	
		WEIGHT		-	
		CUSTOMER DRAWING		-	
		SCALE		2:1	
		SHEET		2 OF 2	
	REV		C		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9